HELLENIC PETROLEUM

ECOLEN® HZ40S

Polipropilen Homopolimer (PPH) Reçine

Sürekli elyaf üretiminde kolay işlenebilirlik ve mükemmel gaz solması (anti-gasfading) direnci.

NotebookLM

1

Akışkanlık (MFI)

25

g/10 dk (230°C, 2.16Kg - ASTM D 1238)

2

Yoğunluk

0.9

g/cm³ (ASTM D 792)

3

Esneklik Modülü

1500

MPa (ASTM D 790)

4

Çekme Mukavemeti (Akma)

36

MPa (ASTM D 638)

5

Kopma Uzaması

%10

(Akma noktasında - ASTM D 638)

6

Darbe Dayanımı (Izod)

30

J/m (Çentikli, 23°C - ASTM D 256)

Belirtilen değerler ortalamadır, ürün spesifikasyonu olarak kabul edilmemelidir.

NotebookLM

Optimize Edilmiş Uygulama Alanları



Sürekli İplik (CF)

Kesintisiz filament üretimi için ideal, pürüzsüz yüzey sağlayan homojen yapı.



Hacimli Sürekli İplik (BCF)

Halı ve benzeri endüstriyel tekstiller için stabil akış ve yüksek renk koruması.



Kesik Elyaf (Staple Fibres)

Kısa formlu elyaf üretim hatlarında yüksek kapasiteli ve güvenilir performans.

NotebookLM

Bu Malzemeyi Neden Seçmelisiniz?



- **Yüksek Akışkanlık Performansı:** 25 g/10 dk eriyik akış hızı (MFI) sayesinde ekstrüzyon hatlarında enerji tasarrufu ve kolay işlenebilirlik (easy processability) sağlar.
- **Spesifik Yüzey Direnci:** Formülündeki mükemmel anti-gasfading (gaz solması direnci) özelliği sayesinde tekstil ürünlerinde uzun ömürlü renk stabilitesini garanti eder.
- **Çok Yönlü Fiber Uyumluluğu:** CF, BCF ve kesik elyaf formlarındaki yoğun, kesintisiz üretim proseslerinin tümüne entegre edilebilir.

NotebookLM

Tasarım Limitleri (Ne Zaman Farklı Bir Grade Seçilmeli?)



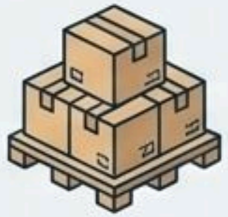
- **Ağır Darbe Emici Parçalar**: Izod darbe dayanımı (30 J/m) standart homopolimer seviyesindedir; yüksek darbe mukavemeti gerektiren ağır hizmet tipi enjeksiyon parçaları için uygun değildir.
- **Yüksek Esneklik Gerektiren Filmler**: Esneklik modülü (1500 MPa) malzeme sertliğini gösterir; yüksek esneme (stretch) istenen ambalaj filmleri yerine yapısal elyaf üretimi odaklıdır.
- **Düşük Akışlı Şişirme Kalıplama:** Reçinenin akışkanlığı oldukça yüksektir (MFI 25); ekstrüzyon şişirme (blow molding) gibi düşük akış gerektiren prosesler yerine iplik/elyaf döküm hatları içindir.

NotebookLM

Operasyon ve Tedarik Parametreleri



Test Koşulları: ASTM standartlarına göre eriyik akış ölçümleri 230°C sıcaklık ve 2.16 Kg yük altında standardize edilmiştir.



Tedarik Şekilleri: Üretim hacminize göre 3 farklı paketleme opsiyonu ile sunulur: 25 Kgs standart paketler, Big Bag (Büyük Çuvallar), Dökme (Bulk) Teslimat.



Güvenlik & Sertifikasyon: Malzeme Güvenlik Bilgi Formu (MSDS), operasyonel uyumluluk için talep üzerine teknik departmanımızdan anında sağlanır.

NotebookLM

“**ECOLEN® HZ40S:** Yüksek akışkanlığı ve eşsiz gaz solması (anti-gasfading) direnciyle; sürekli iplik (CF/BCF) ve kesik elyaf hatlarınızda firesiz, pürüzsüz ve stabil üretim sağlamak için formüle edilmiş nihai çözümdür.”

Detaylı teknik doğrulama ve numune talebi için iletişime geçin.



NotebookLM